

令和6年度後援会総会の書面開催について

令和6年2月17日

東京薬科大学後援会 会員（保証人）の皆様へ

令和6年5月に開催する後援会総会は、書面開催とさせていただきます。このことについては、後援会会則に基づき、令和5年度理事会（令和6年2月17日付開催）で承認をいただきました。

後援会活動の基となる令和6年度の事業計画・予算等をご審議いただきたく、5月中の予定で、総会資料を郵送いたしますので、ご意見を賜りたく、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

東京薬科大学後援会
会長 山崎 康之

本件に関するお問い合わせ

東京薬科大学後援会事務局（学生サポートセンター内）

〒192-0392 東京都八王子市堀之内 1432-1

TEL：042-676-8978（8：45～17：00 平日のみ、土日祝日は除く）

kouenkai-ml@toyaku.ac.jp